



高丹

基础信息

出生年月：1998.10

民族：汉族

籍贯：江西

政治面貌：共青团员

专业方向：电子信息

攻读学位：硕士学位

联系方式

电话：19079973016

邮箱：lynnyedu@163.com

技能证书

- 英语六级证书;
- 计算机 C 语言二级证书;
- C1 驾驶证;
- 办公软件:office;
- 嵌入式开发软件: Keil 、STM32cubeMX 等;
- 仿真软件: comsol、Multisim、Ansys、立创EDA;
- 其他软件: 3D max 、solidworks 。

教育背景

2017.09-2021.06,就读于南昌航空大学,通信工程专业,获工学学士学位;2022.09至今,就读于北京信息科技大学,攻读仪器科学与光电工程硕士学位,清华大学联合培养实验班。

工作经历

2018.9-2019.3, 基于 stm32 语音控制台灯系统 (实物)

实现功能: 通过语音“开灯,亮一点,再亮一点”可控制灯的亮度

主要工作:负责资料查询,后台代码整改、协调小组成员工作、参与测试。

调试问题:

电路上面电压计算失误,最后电路加入 CMOS 管后,灯正常工作。

语音模块这块由于语言是否标准为止,是否接受信号耽误较长时间,后来直接使用滤波器,在说出指令时检测 STM32 输出是否波形正确判别

2021.2-2021.6, 基于 EMWIN 的数据采集系统设计

实现功能: 多路可控数据采集,实时采集,数据存储

调试问题: 多路采集数据,保证传输数据正确性和功能可实现性,其中 DHT11 传输时序和 STM32 单片机 EMWIN 系统工作时间差较大,导致数据传输失误,出现传输不了数据以及出现错误采集数据问题,后来查询资料先设置一个标志请求信号量再中断,从而实现数据的正确传输。

2023.8-2024.8,MEMS 智能传感器设计与验证

实现功能: 可以采集温度、振动、气压等信息,且采集数据的精度较高。

主要工作: 撰写设计报告、验证报告、设计规范,设计实验验证项目指标。

2023.6-2025.6, 无线晶圆测温系统内部热设计

实现功能: 刻蚀过程中,系统使用 IC 集成电子器件制成,可以测量 120-150°C 晶圆温度。

主要工作: 无线通信、晶圆测温器件选型、电路板原理设计、热设计仿真与研究。

荣誉奖项

- 2017-2018、2018-2019、2019-2020、2020-2021 南昌航空大学信息工程学院三等奖;
- 2022-2023 年北京信息科技大学仪器科学与光电工程学院研究生二等奖学金。

学术成果

- 2023.11, 第三届全国集成微系统建模与仿真学术交流会,无线晶圆测温微系统的传热仿真研究,口头汇报。
- 2024.10, 专利: 一种基于绝热填充材料的无线晶圆温度测量装置 (受理中)

自我评价

本人性格沉稳,正直忠诚、执行力强;对工作乐观执着,敢于面对困难与挑战。具有较强的组织领导力及团队合作精神,责任心强;具备良好的业务能力和心理素质,具备较好的抗压能力。